



工序	项目	工艺能力	备注
可加工性	PCB层数	1-18层	
	成品板厚范围	0.6-3.0mm (公差: 0.10mm或+/-10%, 取大者)	喷锡板最小板厚0.8mm
	PCB结构	通孔板、机钻盲孔板	
	PCB材质	FR-4/无卤	高频等特殊材料需提出评审, 无卤仅可物料无卤
	表面处理	有铅喷锡/铅喷锡/化金/OSP/碳油/蓝胶	镀金手指/化银/化锡需提出评审 (需委外加工)
	最大铜厚 (内层/外层)	4oz	超出需提出评审
	PTH半孔板	0.6mm孔以上	
	最小BGA尺寸	0.25mm	0.20mm效率低, 需提出评审
	IC宽度	0.2mm	
	阻抗板、阻抗公差	特性/差分、±10%	
	线宽及PAD公差	≥±10% 或 ≥0.5mil	正常公差+/-20%
	成品尺寸	76*76mm--450*550mm	
	板弯板翘	板厚≤1.0mm, 有SMT 0.75%、无SMD 1.0%; 板厚>1.0mm, 有SMT 0.5%、无SMD 0.75%	单面板/不对称叠构/各层残铜差异大, 板弯曲度不可按此控制, 需提出评审
	标准	IPC 2、3级	IPC 2、3级
开料	最大生产尺寸	单双面板 600*694mm (23.6"*27.3") 多层板 多张PP 540X622mm (21.25"x24.5")	
	开料损耗	4mm/刀	
内层	最小芯板厚度	8mil (0.2mm)	
	HOZ 线宽/线距	3/3mil (0.075/0.075mm)	线宽指原稿线宽、线距, 补偿后最小间距需保证3mil。
	10Z 线宽/线距	4/4mil (0.1/0.1mm)	
	20Z 线宽/线距	6/6mil (0.15/0.15mm)	
	30Z 线宽/线距	8/8mil (0.2/0.2mm)	
	Ring (单边)	≥5mil (0.13mm)	
	Clearance (单边)	≥8mil (0.2mm)	
	隔离线宽度	≥8mil (0.2mm)	
	层间对准度	±1mil (0.025mm)	
	蚀刻因子	≥3.0 (0.08mm)	

压合	钢板尺寸	26"*44.5" (660*1130mm)	
	最小绝缘层厚度	3mil (0.08mm)	
	单边最多PP张数	3	
	压合层偏	±4mil (0.1mm)	
	X-RAY钻靶精度	±1mil (0.025mm)	
机械鑽孔	最小孔径	8mil (0.2mm)	
	最大孔径	254mil (6.45mm)	
	PTH孔径公差	±3mil (0.075mm)	可部分孔径最小公差+/-0.05mm, 需特别管控
	NPT孔径公差	±2mil (0.05mm)	可部分孔径最小公差+/-0.03mm, 需特别管控
	最小槽孔	0.60mm	我司目前最小槽刀0.6mm
	槽孔公差	±4mil (0.1mm)	
	最小槽长/槽宽比	1.5/1	
	PTH孔到铜最小距离 (内层)	四层板7mil、 六层板8mil、 八层及以上板9mil	
	PTH孔到孔最小距离	12mil (0.3mm)	
	最小孔边距	同网络6mil (0.15mm) 不同网络12mil (0.3mm)	
	孔位精度	±3mil (0.075mm)	
	孔壁粗糙度	1.2mil	
鍍銅	最大纵横比	8	
	电镀均匀性	85%以上	
	加工板厚范围	0.8-3.0	
	加工尺寸范围	622mm (24.5") max	
	夹边最小宽度	10mm	
	最大孔铜厚度	依客户要求	
外层蚀刻	线路蚀刻公差	≅ ±10%	正常公差+/-20%
	干膜盖孔能力	≅ 5.0mm	
	蚀刻因子	≧ 3.0	
	H0Z底铜	3/3mil (0.075/0.075mm)	左侧线宽指原稿线宽、线距, 补偿后最小间距需保证3mil。
	10Z底铜	5/5mil (0.13/0.13mm)	
	20Z底铜	8/8mil (0.2/0.2mm)	
30Z底铜	10/10mil (0.25/0.25mm)		

阻焊	塞孔范围	0.25-0.5mm	做菲林
	颜色	绿色/黑色/蓝色/红色/白色	
	最小阻焊桥	非黑色:10Z-3mil/20Z-4.5mil/30Z-5.5mil	
	最小单边开窗	1.2mil (30um)	
	最小阻焊盖线	2mil (50um)	
	最小NPT单边开窗	5mil (0.13mm)	
	线路拐角厚度	≥0.3mil (8 μm)	
	线路表面厚度	≥0.4mil (10 μm)	
	大铜面厚度	≥0.5mil (13 μm)	
文字	颜色 (C&S面)	白色/黑色	
	最小线宽	正字4mil、负字6mil	
	最小字宽/字高/间距	20mil/28mil/4mil	
	距焊盘最小间距	6mil	
成型	常用铣刀规格	0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4 mm	0.8mm/1.0mm效率低, 尽量不使用
	PIN 孔	1.5以上	
	外型尺寸公差	正常±5mil (0.13mm)、最小±4mil (0.1mm)	
	孔/线/PAD/铜到外形最小距离	0.25mm	
	铣槽到板边最小距离	0.3mm	
	铣槽最小宽度	0.8mm	
	最小内R角	0.8mm	
	最小外C角	1.0mm	
V-CUT	模冲孔/槽到边距离	≥板厚	
	V-CUT板厚	0.8mm-3.0mm	
	V-CUT公差	±0.10mm	
	V-CUT跳刀间距	8mm	
	V-CUT余厚公差	±0.10mm	
	V-CUT角度	30度	
测试	最小工艺边	4mm	
	最多测点	10240	
	最大测试尺寸	650*550mm	
	最小测点及节距	0.15mm	